

部品内蔵基板の信頼性

加藤 義尚*, 宗 真太郎**, 韓 榮建*, 堀内 整*, 崔 雲**, 友景 肇***

Reliability Test of Embedded Device Substrates

Yoshihisa KATOH*, Shintaro SO**, Younggun HAN*, Osamu HORIUCHI*,
Woon CHOI**, and Hajime TOMOKAGE***

* 福岡大学半導体実装研究所 (〒 819-1122 福岡県糸島市東 1963-4 三次元半導体研究センター内)

** 福岡大学電子情報工学科 (〒 814-0180 福岡県福岡市城南区七隈 8-19-1)

* Center of System Integration Platform Organization Standards, Fukuoka University (1963-4 Higashi, Itoshima, Fukuoka 819-1122)

** Department of Electronics Engineering and Computer Science, Fukuoka University (8-19-1 Nanakuma, Jonan-ku, Fukuoka 814-0180)